

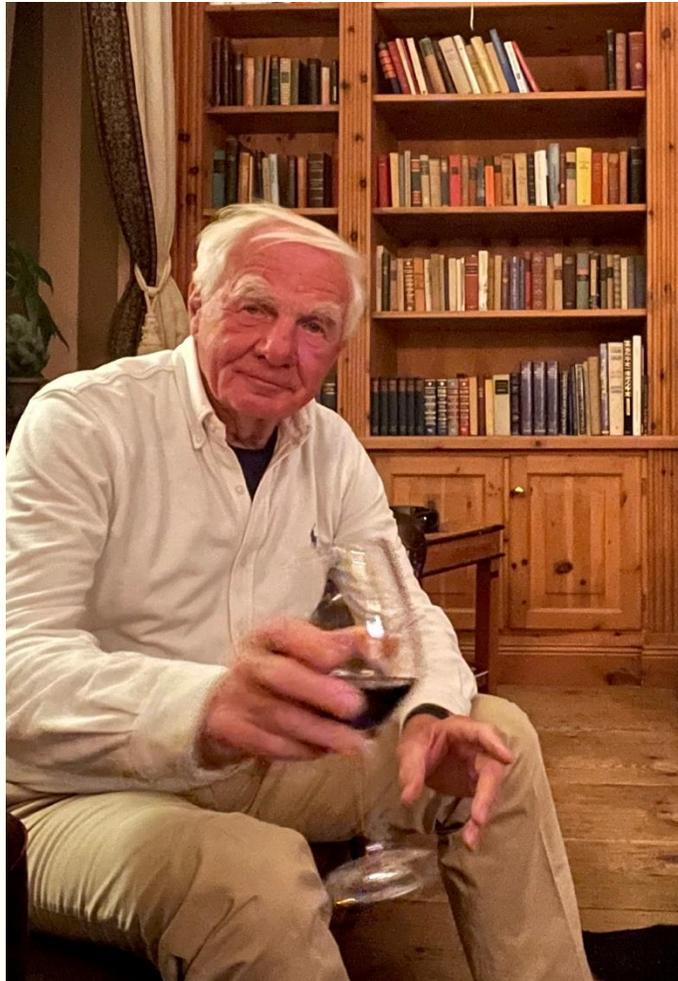
Welcome to Panel

„Advanced Packaging“ und „System Integration“ - Ein Markenzeichen der Hauptstadtregion Berlin

October 8th - 9th | 2025

PHOTONICS DAYS
Berlin Brandenburg
innovationconference





„Advanced Packaging“ und „System Integration“ - Ein Markenzeichen der Hauptstadtregion Berlin

Einführende Bemerkungen

Prof. Dr. Hans Richter

Meilensteine auf den Photonics Days Berlin Brandenburg

October 4th - 7th | 2021

PHOTONICS DAYS
Berlin Brandenburg
innovationconference

GFWW
gegr. 1991

Gesellschaft zur Förderung
von Wissenschaft
und Wirtschaft e.V.

Photonics Days Berlin Brandenburg 2021

Micro-Electronics and Si-Photonics

October 7th, 10:00 - 12:00 (Session 1) and 15:00 - 18:00 (Session 2)

(Hybrid and in presence in Berlin-Adlershof)

October 9th - 10th | 2023

PHOTONICS DAYS
Berlin Brandenburg
innovationconference

GFWW
gegr. 1991

Gesellschaft zur Förderung
von Wissenschaft
und Wirtschaft e.V.

Conference: „Microelectronics and Photonics an important economic factor for the Region“

10. Oktober 2023, 9:00 am- 6:00 pm,
WISTA Event Center, „Einstein-Kabinett“
Rudower Chaussee 17, 12489 Berlin-Adlershof

Vorträge sind abrufbar unter <https://www.eleb2.de/index.php/de/archiv/21-archiv-2023>

Meilensteine auf den Photonics Days Berlin Brandenburg

October 4th - 7th | 2021



Gesellschaft zur Förderung
von Wissenschaft
und Wirtschaft e.V.

gegr. 1991

Photonics Days Berlin Brandenburg 2021

Micro-Electronics and Si-Photonics

October 7th, 10:00 - 12:00 (Session 1) and 15:00 - 18:00 (Session 2)

(Hybrid and in presence in Berlin-Adlershof)

Chairs: Prof. Dr. Hans Richter (GFWW e. V., Frankfurt (Oder))

P. Krause (Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH, Wittenberge)

In this conference we will give an overview of trends in technology, packaging technology, applications in diverse field and challenges in the market, focused on the key technologies automotive, industry safety / security, information technology and artificial intelligence. The capitol region can look back on a tradition more than 60 years in micro-, opto- and power electronics.

Meilensteine auf den Photonics Days Berlin Brandenburg

October 9th - 10th | 2023

PHOTONICS DAYS
Berlin Brandenburg
innovationconference

GFWW
gegr. 1991

Gesellschaft zur Förderung
von Wissenschaft
und Wirtschaft e.V.

Conference: „Microelectronics and Photonics an important economic factor for the Region”

Chairs: - Hans Richter, Management GFWW, Frankfurt (Oder)
- Peter Krause, Director Prignitz MST GmbH, Wittenberge

1. Date / Location: 10. Oktober 2023, 9:00 am- 6:00 pm,
WISTA Event Center, „Einstein-Kabinett“
Rudower Chaussee 17, 12489 Berlin-Adlershof
2. Issue / Cause: Clue on the grown potentials
and competences in the industrial sector
Microelectronics in the Region Berlin – Brandenburg,
repositioning of Microelectronics
„Made in Germany / Europe“

Location Berlin before 1939

Berlin

größte und vielseitigste Industriestadt Deutschlands

Vorherrschende Industriezweige

Elektrotechnik, Elektronik und Gerätebau, Maschinenbau, ...

1847

Gründung der "Siemens & Halske AG"

1887

Gründung der "Deutschen Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität" (seit 1887 dann AEG)

1910

Gründung der "Deutsche Hollerith Maschinen GmbH", später
"Internationale Büromaschinen GmbH" (1914 Kauf durch IBM)

Setup of Semiconductor industry

1951

Werk für Fernmeldewesen Berlin,
ab 1960 Werk für Fernsehelektronik; Halbleiterproduktion
(Germaniumdioden) ab 1957

1952

Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik Teltow

1958

Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

1960

Institut für Halbleitertechnik Stahnsdorf

1965

Gleichrichterwerk Stahnsdorf

Erfolgreicher Strukturwandel

Berlin entwickelt sich zu einem Zentrum der Kommunikationsbranche



»Die Elektro-
nik- und Infor-
mationstech-
nikindustrie
ist der
stärkste
Industriezweig
in Berlin«

»Neben den
Hochschulen
hat Berlin
250 außer-
universitäre
Forschungs-
einrich-
tungen«

Der IC-Industrie steht ein tiefgreifender Wandel bevor

Im Kommen: Systems on Package

»Die IC-Industrie muss umdenken«, fordert Prof. Dr. Herbert Reichl vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) in Berlin: Stärker als bisher werde das Endprodukt auf die Eigenschaften seiner elektronischen Komponenten rückwirken.

München – Während SoCs (System on Chip) für künftige Anwendungen wegen der vielen Prozessstufen nicht flexibel genug seien, stellten Hybridlösungen eine gute Alternative dar: SoB (System on Board), SoF (System on Flex), SoW (System on Wafer) und Kombinationen davon. Dadurch entstehen heterogene Systeme oder SoPs

und mechanisch-optische Kombinationen integriert werden. Diesen Trends folgend, ist das IZM an einem neuen, vom BMBF geförderten Projekt namens »e-Grain« beteiligt. Für Prof. Dr. Reichl stellt es einen »neuen Ansatz in der Systemintegration« dar: e-Grain sieht



Prof. Dr. Herbert Reichl,
Fraunhofer IZM: »Neuer Ansatz
in der Systemintegration«

Berlin habe mal den Charme einer alternden Lady gehabt, gibt ein Unternehmer aus der Elektronikbranche zu Protokoll, aber davon sei nichts geblieben. Berlin, erinnert er sich, das war bis in die 50er-Jahre hinein einer der größten Industriestandorte der Welt. Bis in die 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts hinein galt Berlin als Zentrum der Nachrichtentechnik.

Selten dürfte in den 20er- und 30er-Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die Zahl der an verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen tätigen Nobelpreisträger höher gewesen sein als in Berlin. Nils Bohr und Lise Meitner arbeiteten im Auftrag der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Albert Einstein entwickelte seine Relativitätstheorie weiter, und Otto Hahn versuchte sich an der Spaltung des Atoms.



Berlin Marathon, Love-Parade, das sind die Spektakel, in deren Licht sich die Stadt heute gerne sonnt. Der Wandel vom Produktions- zum Dienstleistungssektor wurde nach Ansicht des derzeitigen Wirtschafts-Senators in der Vergangenheit zu sehr betont. Allein die Einsicht, dass auch eine Großstadt wie Berlin einen leistungsfähigen industriellen Kern braucht, um zu überleben, sie könnte zu spät kommen. Die Bereitschaft,

Aktive Wirtschaftshilfe durch Zurückschneiden der Bürokratie

»Dass Berlin keine Industrie will, ist ein Missverständnis«

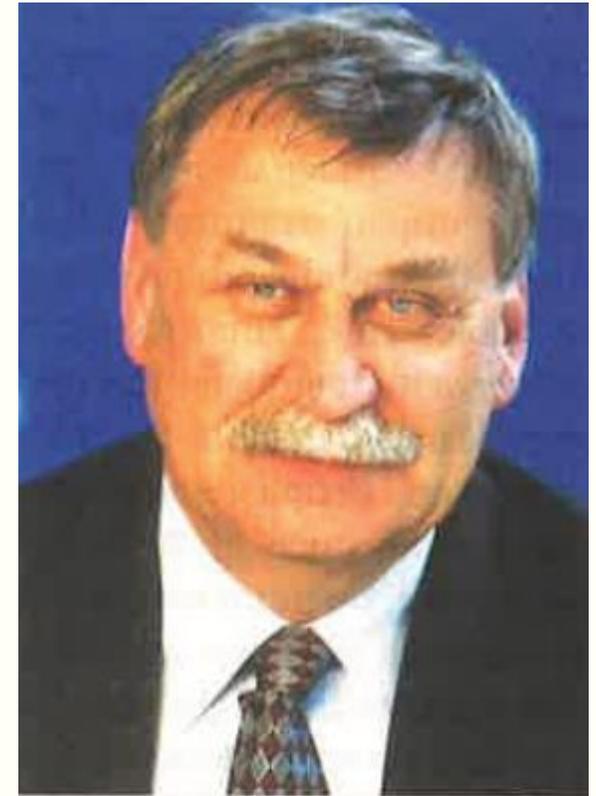


**Harald Wolf, Senator für Wirtschaft,
Arbeit und Frauen**

» Die Politik hat sich in der
Vergangenheit zu sehr auf den
Strukturwandel vom produzierenden
Gewerbe zum Dienstleistungssektor
fixiert, Berlin braucht aber
zukünftig einen leistungsfähigen
Industriellen Kern. «

»Electronic Packaging wird zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor für Europa«

»Electronic Packaging« entwickelt sich zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Systemhersteller in den Bereichen Consumer-Elektronik, Telekommunikation, Maschinenbau und auf dem Automobilsektor. »Wer sich in diesen Branchen international behaupten will, muss auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklung sein«, erklärt Prof. Herbert Reichl, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM).



Prof. Herbert Reichl, Fraunhofer IZM

» Die Zeiten der Sensor- und Aktuator-Komponenten sind Vergangenheit. Wir denken in Mikrosystemen. «

nen Werk erfolgen, berichtete das „Handelsblatt“. Packaging nennt man das in der Chipindustrie. „Das wäre genau das Richtige für die Hauptstadtregion“, sagt der Frankfurter Professor Hans Rich-

„ Verpackungen für Chips – da hat die Region Potenziale.

ter. Er hat als Forscher Erfolge ge-

Märkische Oderzeitung 02.12.2021

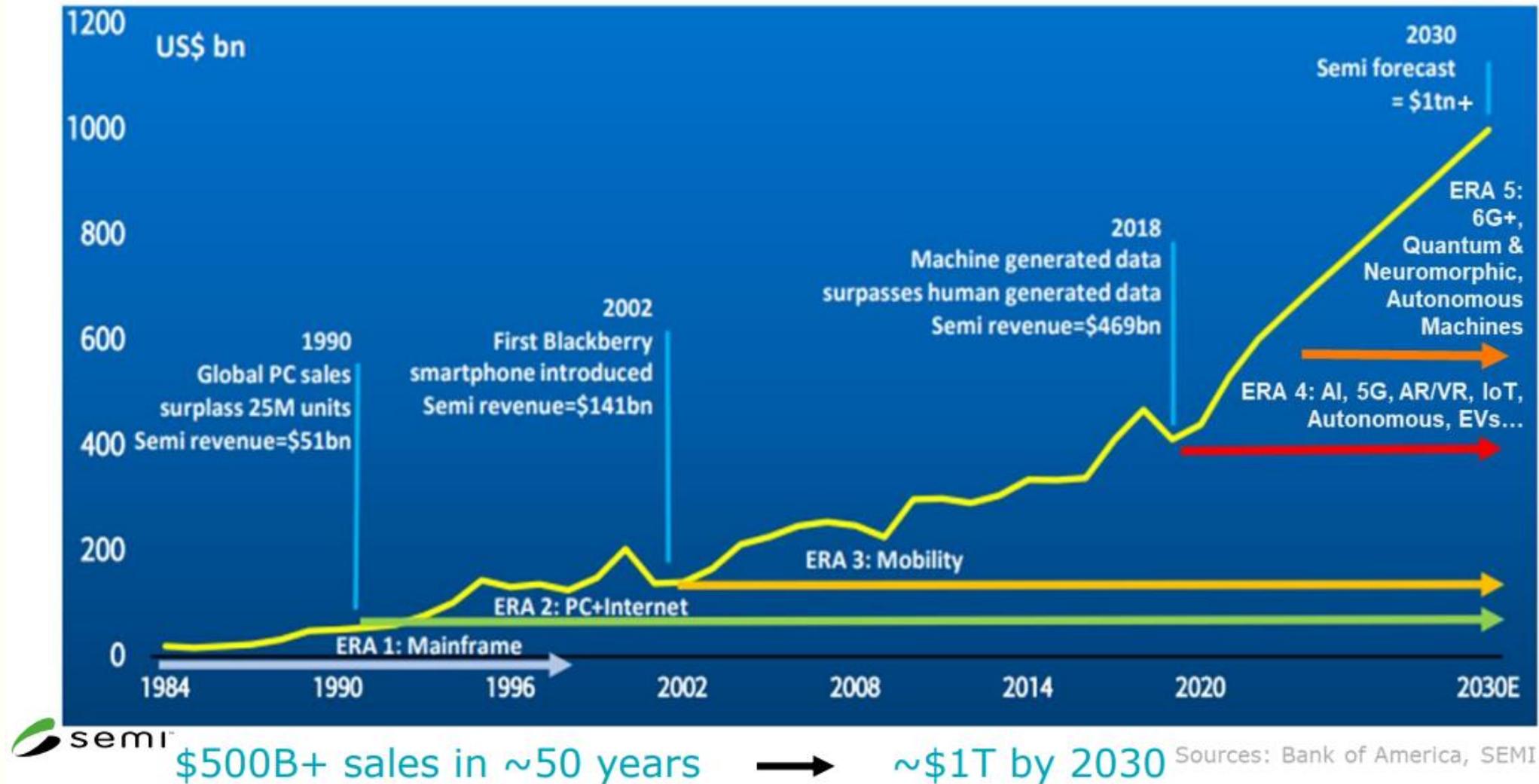
Investitionen des US-Chipriesen Intel könnten eine Chance für Europa sein. Angeblich schaut sich Intel bereits in Bayern und in der Nähe von Magdeburg nach großen Gewerbeflächen für eine Chipfabrik um. Intel plant eine Foundry – eine Fabrik, die Auftragsfertigung erledigt.

das neue Hoffnungen. Eine Intel-Fabrik für Verpackungen, für Packaging, „wäre genau das Richtige“ für die Region, meint der Frankfurter Hans Richter.

sagt Richter. Und Intel fände Kompetenzen in der Region vor. Die Nauener Firma PacTech beispielsweise stellt Verpackungsausrüstungen für die Mikroelektronik her. Die 32 Mitarbeiter der Bos GmbH in Berlin produzieren und entwickeln Ausrüstungen und Geräte.

ist Prignitz Mikrosystemtechnik aus Wittenberge. Sieben Jahre hat das Unternehmen in die Entwicklung einer Technik gesteckt, die Zukunft hat: Drucksensoren für Wasserstoff. Sie werden für die neue Wasserstoffwirtschaft gebraucht. Oder Silicon Radar aus Frankfurt (Oder) entwickelt Radarchips für Autos und Medizintechnik. Swissbit Germany mit Sitz in Berlin produziert Speicher- und Sicherheitstechnik für die Industrie.

Digitization Driving Exponential Growth, \$1T by 2030



„Advanced Packaging“ und „System Integration“

Besondere Merkmale der Industriebranchen Nano-/ Mikroelektronik und Photonik

Nano- und Mikroelektronik:

- Branche wird dominiert von global agierenden Unternehmen
- Investitionskosten für neue Fabs liegen zwischen 5 - 40 Mrd. USD
- Die strategisch wichtigen Forschungs- und Entwicklungsthemen erfolgen Firmen-intern
- Standortwahl wird global entschieden

Photonik:

- In der Branche dominieren KMUs, Start Ups spielen eine große Rolle
Die Unternehmen unterhalten enge Kooperationen zu staatlichen Forschungseinrichtungen und Universitäten
- Hoher Innovationsgrad
- Hohe Ortsbindung

(Cluster Optik und Photonik: In Berlin 12.479 Beschäftigte, 813 Unternehmen, 1,6 Mrd. Umsatz, Quelle: WEBSITE, Senat)

Und: Beide Branchen sind Qualitäts-getrieben. Im Vergleich dazu ist die Photovoltaikindustrie Kosten-getrieben



GRW-Kooperationsnetzwerk „ERT-BB“ – Wie weiter?

1. Anliegen:

Das GRW-Kooperationsnetzwerk „ERT-BB“ hat in der Phase 3 das Ziel **Berlin - Brandenburg zu einem Pfeiler der sich neu entwickelnden europäischen Halbleiterindustrie mit Alleinstellungsmerkmalen** zu entwickeln und sich in Form einer neuen Organisationsstruktur mit breiteren Kompetenzen und dem Zusammenschluss von Industriebereichen zu positionieren. Dafür ist ein Zeitraum von 2 Jahren vorgesehen. Diese neue Struktur soll eng verknüpft sein mit bereits bestehenden Strukturen in anderen Bundesländern bzw. Europa. Eines der wichtigsten Anliegen dabei ist es, Klein- und Mittelständische Firmen in Wertschöpfungsketten sichtbar zu machen, die Potenziale nach außen darzustellen und auf die politischen Ziele zur wirtschaftlichen Souveränität einzuzahlen.

2. Ausgangssituation

Das Cluster Optik und Photonik in Berlin - Brandenburg setzt in seiner neuen Ausrichtung auf drei Schwerpunkte:

- Photonik
- Mikroelektronik
- Quantentechnologien

3. Ziel

In der fortgeschrittenen Silizium-basierten Mikroelektronik im Technologiebereich mit Strukturabmessungen unter 10 nm trifft sich die Mikroelektronik mit der Photonik:

Sowohl der Stromtransport der Ladungsträger als auch deren Kopplung an das Lichtfeld der Photonen lassen sich in diesen kleinen Strukturen weitgehend nur noch quantenmechanisch beschreiben.

D. h. es erfolgt gleichzeitig die Nutzung Quantenmechanischer Prinzipien, womit die Bedeutung der Verschmelzung der Disziplinen immer mehr in den Vordergrund rückt.

Auf den beiden Themenfeldern Mikrointegration und Photonik ist die Region Berlin - Brandenburg sowohl mit am Weltmarkt beteiligten Unternehmen als auch mit einer herausragenden Forschungs- und Hochschullandschaft aktiv und präsent. Berlin - Brandenburg ist damit prädestiniert, ein tragender Pfeiler einer sich entwickelnden europäischen Halbleiterindustrie mit Alleinstellungsmerkmalen in der Mikrointegration verbunden mit Advanced-Packaging zu werden und ergänzend zu den auf Halbleiterindustrie ausgerichteten Regionen in Deutschland und Europa aufzutreten.

„Regional kombinieren wir die für die Mikroelektronik immer zentralere Mikrointegration in Form von Advanced-Packaging mit Photonics.“

4. Zeitleiste:

Start: 1. August 2025

Ende: 31. Juli 2027

Etablierung der neuen Organisationsstruktur bis 2027

5. Akteure:

Mitglieder des GRW-Netzwerkes aus Phase 1

u. a. Swissbit Germany AG

Pac Tech GmbH, Nauen

Scharnau GmbH

Prignitz MSD GmbH

BOS GmbH

budatec GmbH

AUCOTEAM GmbH

INSENSO GmbH

Neu zu gewinnende Mitglieder

GFWW e. V. für das Themenfeld Mikroelektronik

OpTecBB e. V. für das Themenfeld Photonik

Gesamtleitung GFWW e. V.

Die GFWW ist auf Basis ihrer Kompetenzen nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv, managed erfolgreich Netzwerk- und Kooperationsprojekte, betreut Graduerungsarbeiten, sie ist auch als Denkfabrik für strategische Studien aktiv.

6. Kooperationspartner:

Silicon Saxony, Dresden

OptoNet, Jena

SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International - Milpitas, Kalifornien / USA

AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e. V., Berlin

Elektronische Mess- und Gerätetechnik Thüringen (ELMUG) eG, Ilmenau

Silicon Junction Magdeburg

Mit diesen Netzwerken / Clustern unterhält die GFWW ausgenommen Silicon Junction Magdeburg eine gegenseitige Mitgliedschaft als Basis der langjährigen Kooperation, so mit Silicon Saxony seit 2002, mit OptoNet 2009, mit SEMI seit 2011, mit AMA 2014, mit ELMUG seit 2020.

7. Nutzer:

Berlin - Brandenburg hätte damit für die zukünftigen Technologietrends der Mikroelektronik einen sichtbaren Fußabdruck und dies sollte dazu führen, dass sich die Industrie entwickelt. Aus kleinen KMUs könnten robuste und somit souveräne Globalplayer entstehen. Technologietrends designed & made in Berlin/Brandenburg würden eng verknüpft mit Silicon Saxony und den Zentren in Grenoble (Frankreich) und Leuven (Belgien) Bestandteil einer vertrauensvollen europäischen Lieferkette werden.

In Zukunft geht es nur zusammen, weil die Mikroelektronikwelt komplexer und viel dynamischer werden wird, was auch eine Vielzahl an Chancen und Potentialen beinhaltet. Wenn wir uns nicht organisieren und kollaborieren wird uns die globale Konkurrenz perspektivisch noch weiter davonlaufen. Es sei daran erinnert, dass Europa nur mit 9 % an der Weltweiten Chip-Produktion beteiligt ist und bis 2030 ein Anteil von 20% erreichen möchte. Wir liefern einen wertvollen und bedeutenden Beitrag dazu.

- KMUs / GUs

Die Unternehmen erwarten die Vernetzung in einem Ökosystem zusammen und in Ergänzung zu anderen etablierten und in der Regel Halbleiter-ausgerichteten Netzwerken speziell für die Mikrointegration, wo sich auch Photonik mit Mikroelektronik trifft und zukünftig Quantentechnologien noch stärker industriell genutzt werden. Konkret ist die Rede von einem „System Integration Excellence Netzwerk“. Architekturrends wie z.B. System on Package und Chiplets zeigen genau darauf und wir benötigen in Europa ein starkes Cluster der kompletten Wertschöpfungskette für die Systemintegration. Die Region ist dahingehend schon sehr gut ausgestattet mit Materiallieferanten, Anlagelieferanten, Entwurfskompetenzen, Integratoren (Packaging), Testhäusern und sogar IDM's (Integrated Device Manufacturer), was durch Spitzenforschung und Hochschulen in dem Gebiet fundamntiert ist. Damit sollten weitere Teile der Wertschöpfungskette nach dem Chip zur Kooperation motiviert werden. Gestützt und gefördert durch Politik und deutlich enger verzahnt mit der Forschung und Ausbildung.

- Einbau kleinerer Firmen in Wertschöpfungsketten
- Einbeziehung kleinerer Zulieferer
- Vernetzung der Kompetenzen
- Hochschul- und Forschungseinrichtungen
- Ausbau der regionalen Kooperationsbeziehungen zu Unternehmen auf den Gebieten Forschung, Aus- / Weiterbildung
- Unterstützung von start-ups

- Regionale Wirtschaft
- Einbeziehung von KMUs in etablierte Wertschöpfungsketten und Zulieferbeziehungen
- Standort Deutschland / Europa
- Etablierung der Mikrointegration verbunden mit Advanced Packaging als eins der Alleinstellungsmerkmale der Halbleiterindustrie mit Konzentration im Raum Berlin – Brandenburg

8. Erfolgswahrscheinlichkeit:

Hoch, da

a) bereits auf ein stabiles Netzwerk zurückgegriffen wird und das Vorhaben

b) in Einklang mit der Forschungspolitischen Zielstellung Deutschlands, die Halbleiterindustrie auszubauen und

c) sie einpasst in das Europäische Programm CHIP ACT

9. Finanzierung:

Offen!

Anfang Juni 2024 wurde durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg mitgeteilt, dass die vom Netzwerk vorgesehene Weiterführung in einer Phase 3 durch das Land Brandenburg nicht vorgesehen ist.

10. Quellen:

„The Global Market for Advanced Semiconductor Packaging 2024-2035“, Future Markets, Inc., March 2024, 346 Seiten

Robert Chau, „Accelerating Europe’s R&D Advancement in Semiconductor and Packaging Technologies“, SEMI Industry Strategy Symposium Europe 2024, Wien

www.eleb2.de

5. Sachbericht, GRW-Kooperationsnetzwerk „ERT-BB“, 13.03.2024, 10 Seiten

Swissbit Initiatives European advanced packaging strategy 2024, Swissbit Germany AG, 2024

H. Richter, GRW-Kooperationsnetzwerk „ERT-BB“, **Arbeitsplan 01.01.2024 - 31.07.2024**, 4 Seiten

H. Richter, „**Einige Bemerkungen zum Stand der Branche Mikroelektronik / Halbleiter in den Bundesländern Brandenburg und Berlin in Verbindung mit den Photonics Days Berlin Brandenburg 2023**“, 14.09.2023, 2 Seiten

H. Richter und U. Wulf „**With Moore’s law from microelectronics to quantum electronics**“, Inside E-MRS World, Strasbourg 2024, 17 Seiten (to be published)

PS: Beraten auf dem Netzwerkmeeting am 23.07.2024 beim Netzwerkmitglied Pac Tech - Packaging Technologies GmbH in Nauen

Swissbit expandiert

Vom Speicher-Chip bis zu Security-Systemen

Swissbit hat die neue Fertigung am Standort Berlin-Marzahn im Dezember vergangenen Jahres in Betrieb genommen und damit die Produktionskapazitäten für hochintegrierte Elektronikmodule auf Basis der neusten 3D-Packaging-Techniken verdreifacht. Bis 2023 will Swissbit am Standort die Zahl der Arbeitsplätze von 200 auf bis zu 300 in Entwicklung und Produktion ausbauen. Auf der neuen



Blick in die neue Fertigung
von Swissbit in Berlin-Marzahn

In der neuen Fabrik in Berlin-Marzahn fährt Swissbit auf knapp 2600 m² reiner Produktionsfläche industrietaugliche Fertigung von Speicher- und Security-Modulen auf Basis der neusten 3D-Packaging-Techniken hoch.



Silvio Muschter, CEO von Swissbit

„ Wir haben uns von den Speicherkarten ausgehend zu einem Hersteller von umfassenden IoT-Security-Systemen entwickelt und dazu die eigene Division „Embedded IoT Solutions“ gegründet. Dafür sehe ich in unterschiedlichen Marktsektoren ein riesiges Potenzial. “

»Wir sind mehr als ein OSAT!«

Swissbit steigt ins Packaging-Foundry-Geschäft ein

Swissbit stellt die Weichen für die Zukunft und bietet ihre Advanced-Packaging-Prozesse am offenen Markt an: »Ab sofort stehen wir als Packaging-Foundry zur Verfügung – und verhelfen damit der europäischen Industrie zu mehr Souveränität«, sagt Lars Lust von Swissbit gegenüber Markt&Technik.



Lars Lust, Swissbit

„Wir sind der einzige Speicherproduktanbieter in Europa mit eigenem Design und eigener Fertigung, also ein IDM, lediglich die Front-End-Fab fehlt. Das ist in dieser Tiefe nicht nur in Europa einzigartig, das ist auch global sehr selten! Unser großes Ziel besteht nun darin, im Rahmen des EU Chips Act „First of a Kind Technology“ in Europa aufzubauen, eine riesige Chance für Europa!“

1. Absicht, Anliegen und Ziel

- Die Halbleiterindustrie in Europa positioniert sich neu, inbegriffen die der Chipherstellung nachgeordnete Packaging-Technologie (z. B. **Advanced Packaging**, Kombination von Funktionsblöcken → Chiplets, Si-Photonik, **Mikrointegration**)
- Die Region Berlin Brandenburg nutzt diese Chance und stellt sich als **Pfeiler der europäischen Halbleiterindustrie** mit Alleinstellungsmerkmalen dar (s. Allianz der europäischen Halbleiterregion, z. Z. 13 Standorte in 9 Staaten)
- Dazu ist eine **neue Netzwerkstruktur** aufzubauen, die auf die Branchen Mikroelektronik und Photonik zurückgreift und sich auf **europäischer Ebene** positioniert
- „Regional **kombinieren wir** die für die Mikroelektronik immer zentralere Mikrointegration in Form von **Advanced Packaging mit Photonics** als Kern



Podiumsdiskussion

09.10.2025

Berlin - Adlershof, Hertz Kabinett, 16:30 - 18:00 Uhr

„Advanced Packaging und Systemintegration -“ Ein Markenzeichen der Hauptstadtregion Berlin



Einführung: **Prof. Dr. Hans Richter**,
Vorstandsvorsitzender, GFWW e. V., Frankfurt (Oder)

ergänzt durch **Mariusz Rzeznikiewicz**,
„Wertschöpfungsketten in der Mikroelektronik sind Länderübergreifend“



Peter Krause,
Geschäftsführer INSENSO GmbH, Berlin
und Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH, Wittenberge,
Vorstandsvorsitzender
AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V.



Lars Lust,
General Manager APAT Solutions
Swissbit Germany AG, Berlin



Mariusz Rzeznikiewicz,
Beauftragter BVMW, Frankfurt (Oder)



Gesellschaft zur Förderung
von Wissenschaft
und Wirtschaft e.V.

gegr. 1991

Chancen

- Neue Wege für Chip-Leistungssteigerung durch Advanced Packaging
- Hohes Wertschöpfungspotenzial für Design (bis zu 50 Prozent der gesamten Wertschöpfung)
- Mit der Forschungsfabrik Mikroelektronik ist Deutschland starker Technologiepartner
- Einbettung in das EU-Ökosystem (EU Chips Act und Chips Joint Undertaking)
- Stark wachsende Nachfrage nach Hochleistungschips aus den Segmenten KI und Rechenzentren
- Vertrauenswürdige Chip-Hardware entlang der gesamten Lieferkette von der Produktion bis zum Kunden sollte durchgehend sicher, nachvollziehbar und zuverlässig sein, z. B. durch innovative KI-Verfahren mit Privacy-by-Design
- Verlässliche internationale Technologiepartner, z. T. bereits vor Ort investiert
- Vielfältige Anwendungsfelder

**Hightech Agenda
Deutschland**





Podiumsdiskussion

09.10.2025

Berlin - Adlershof, Hertz Kabinett, 16:30 - 18:00 Uhr

„Advanced Packaging und Systemintegration -“ Ein Markenzeichen der Hauptstadtregion Berlin



Einführung: **Prof. Dr. Hans Richter**,
Vorstandsvorsitzender, GFWW e. V., Frankfurt (Oder)

ergänzt durch **Mariusz Rzeznikiewicz**,
„Wertschöpfungsketten in der Mikroelektronik sind Länderübergreifend“



Auch Sensorik
braucht Packaging

Peter Krause,
Geschäftsführer INSENSO GmbH, Berlin
und Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH, Wittenberge,
Vorstandsvorsitzender
AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V.



From Lab to Fab
to Foundry

Lars Lust,
General Manager APAT Solutions
Swissbit Germany AG, Berlin



Halbleitercluster
entlang der Oder

Mariusz Rzeznikiewicz,
Beauftragter BVMW, Frankfurt (Oder)



Gesellschaft zur Förderung
von Wissenschaft
und Wirtschaft e.V.
gegr. 1991

Chancen

- Neue Wege für Chip-Leistungssteigerung durch Advanced Packaging
- Hohes Wertschöpfungspotenzial für Design (bis zu 50 Prozent der gesamten Wertschöpfung)
- Mit der Forschungsfabrik Mikroelektronik ist Deutschland starker Technologiepartner
- Einbettung in das EU-Ökosystem (EU Chips Act und Chips Joint Undertaking)
- Stark wachsende Nachfrage nach Hochleistungschips aus den Segmenten KI und Rechenzentren
- Vertrauenswürdige Chip-Hardware entlang der gesamten Lieferkette von der Produktion bis zum Kunden sollte durchgehend sicher, nachvollziehbar und zuverlässig sein, z. B. durch innovative KI-Verfahren mit Privacy-by-Design
- Verlässliche internationale Technologiepartner, z. T. bereits vor Ort investiert
- Vielfältige Anwendungsfelder

Hightech Agenda Deutschland



**Tatsachen zu benennen bedeutet noch nicht,
sie umgesetzt zu haben.**

**Wem um die Sache zu tun ist, der muss Partei zu
nehmen wissen, sonst verdient er nirgends zu wirken.**

Johann Wolfgang von Goethe

Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.

Johann Wolfgang von Goethe